

May 9, 2006

拒絶理由通知書

Office Action

特許出願の番号 特願2002-077230
起案日 平成18年 4月25日
特許庁審査官 金澤 俊郎 8614 3D00
特許出願人代理人 下田 容一郎(外 1名) 様
適用条文 第29条第2項

この出願は、次の理由によって拒絶をすべきものである。これについて意見があれば、この通知書の発送の日から60日以内に意見書を提出して下さい。

理 由

この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前日本国内又は外国において頒布された下記 of 刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。

記 (引用文献等については引用文献等一覧参照)

- ・ 請求項 1
- ・ 引用文献等 1、2、3
- ・ 備考

引用文献1には、特に、段落【0025】を参照すると、車両骨格部内の空間に粉粒体を充填した車両骨格構造が記載されていると認める。

また、引用文献2には、中空セラミック球を充填した緩衝材が記載されていると認める。

また、引用文献3には、多孔質粒状体を充填したパネル構造が記載されていると認める。

前記引用文献1と引用文献2、3とは共に構造部材内に粒状体を充填することで、構造部材に加わる荷重を粒状体の運動エネルギーにより吸収する点で共通の機能を有すると認められるから、引用文献1に記載された粉粒体に、引用文献2、3に記載された中空セラミック球又は多孔質粒状体を適用して、本願請求項1に係る発明とすることは、当業者が容易に想到し得る程度であると認められる。

- ・ 請求項 2
- ・ 引用文献等 1、2、3

・備考

請求項1に対する備考

及び引用文献2には、中空セラミック球を結合剤により結合して成形した緩衝材が記載されていると認める。

この拒絶理由通知書中で指摘した請求項以外の請求項に係る発明については、現時点では、拒絶の理由を発見しない。拒絶の理由が新たに発見された場合には拒絶の理由が通知される。

引用文献等一覧

1. 特開2001-130444号公報
2. 特公昭54-025189号公報
3. 特開2001-349372号公報

先行技術文献調査結果の記録

調査した分野 IPC B62D 25/10
 F16F 7/12

この拒絶理由通知の内容に関するお問い合わせ等がございましたら下記までご連絡下さい。

特許審査第2部運輸

TEL. 03(3581)1101 内線3341 FAX. 03(3580)6904